



「バックホウ+α」で実現する ICT 中層混合処理

ダイナWミキシング工法

日時：2025年12月4日(木)～12月5日(金)

会場：ポートメッセなごや

ブース番号：か32 (第3展示館)

サン・エンジニア

ダイナWミキシング工法 とは

・バックホウに攪拌アタッチメントを接続するだけで、中層混合処理ができます

深度0.5～5.0m : バイブロ・バケット型 (VB)

深度3.0～10.0m : ショート・トレンチャ型 (ST)

・ICT管理装置 (マルチGNSS) により、施工状況を3D数値データ管理します

ガイダンス機能等により、初心者オペが即戦力になります

リアルタイムログデータが、ベテランの勘を補助し高品質化します

施工状況が見える化し、施工管理者の負担が減少します



NETIS登録番号：
QS-250008-A



NETIS登録番号：
QS-250006-A

